

2018年3月9日

## 銅張積層板、プリプレグおよび内層回路入り多層基板材料の 価格改定について

パナソニック株式会社 オートモーティブ&インダストリアルシステムズ社は、電子回路基板材料として製造・販売している銅張積層板、プリプレグおよび内層回路入り多層基板材料(当社製品名:プレマルチ)の価格を改定致します。

当社は、電子回路基板の主要原材料の価格上昇を背景に、銅張積層板、プリプレグ、内層回路入り多層基板材料の価格改定を2017年に実施しました。その後も、中国の環境規制強化によるエポキシ樹脂原材料の供給量減少、原油価格の上昇、電子回路基板の世界的に旺盛な需要増加による需給バランスの逼迫などを背景に、電子回路基板の主要原材料であるエポキシ樹脂、銅箔、ガラスクロスの価格が、高騰し続けています。

このような中、製品の安定供給を優先するため、製造合理化・コスト削減を原資として、原材料価格上昇を一部受け入れ、内部吸収を図って参りましたが、さらなる上昇分を自助努力で吸収することが難しい状況となっています。需給バランスの逼迫は当面継続すると予想されることから、製品の安定供給を図るためにも、原材料価格の上昇分の一部を以下の通り製品価格に反映させていただくこととなりました。

### ■価格改定対象製品と現行価格に対する改定幅

対象製品	現行価格に対する改定幅
銅張積層板	現行価格の+10%
プリプレグ、接着絶縁シート	現行価格の+8%
内層回路入り多層基板材料 (当社製品名:プレマルチ)	現行価格の+5%

### ■実施時期

2018年4月1日出荷分より

### 【お問合せ先】

オートモーティブ&インダストリアルシステムズ社 電子材料事業部  
[https://industrial.panasonic.com/cuif/jp/contact-us?  
field\\_contact\\_group=2201&field\\_contact\\_lineup=3248&ad=press20180309](https://industrial.panasonic.com/cuif/jp/contact-us?field_contact_group=2201&field_contact_lineup=3248&ad=press20180309)

以上

プレスリリースの内容は発表時のものです。  
商品の販売終了や、組織の変更等により、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。